

广发证券股份有限公司
关于北京康美特科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市
之

发行保荐书



二〇二五年六月

声 明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“保荐人”或“保荐机构”）及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。

如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《北京康美特科技股份有限公司招股说明书》一致。

目 录

声 明	1
目 录	2
第一节 本次证券发行基本情况	3
一、本次证券发行的保荐机构	3
二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况	3
三、发行人基本情况	3
四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系	4
五、保荐机构内部审核程序和内核意见	5
第二节 保荐机构的承诺事项	8
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见	10
一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论	10
二、本次证券发行所履行的程序	10
三、本次证券发行符合规定的发行条件	11
四、发行人存在的主要风险	14
五、对发行人发展前景的评价	21
六、其他需要说明的事项	30

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行的保荐机构

广发证券股份有限公司。

二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况

（一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况

哈馨女士，保荐代表人，先后主持或参与了北方国际（000065）配股、新风鸣（603225）非公开发行、中际旭创（300308）非公开发行联席主承销、康美特（874318）新三板推荐挂牌和日津科技（834555）、振威会展（834316）新三板推荐挂牌及后续股票定向发行等项目，具备扎实的资本市场理论基础和较为丰富的投资银行业务经验。自执业以来，执业记录良好，未受到监管部门的处罚。

李英杰先生，保荐代表人，先后主持或参与了中石化（600028）向特定对象发行股票、交通银行（601328）向特定对象发行股票联席主承销、北方长龙（301357）创业板 IPO 等项目，具备扎实的资本市场理论基础和较为丰富的投资银行业务经验。自执业以来，执业记录良好，未受到监管部门的处罚。

（二）本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况

曲可昕女士，商业分析硕士，主要参与了中石化（600028）向特定对象发行股票、康美特（874318）新三板推荐挂牌，越升科技（874516）新三板推荐挂牌及股票定向发行等项目。自执业以来，执业记录良好，未受到监管部门的处罚。

（三）项目组其他成员姓名

本次证券发行项目组其他成员为：孙志敏、王佳丽、李非凡、戴宁、王金锋、余路遥。

三、发行人基本情况

公司名称	北京康美特科技股份有限公司
英文名称	Beijing KMT Technology Co.,Ltd.
法定代表人	葛世立
注册资本	12,020.00 万元

公司名称	北京康美特科技股份有限公司
成立日期	2005年4月27日
注册地址	北京市海淀区永腾北路9号院7号楼1层101室
办公地址	北京市海淀区永腾北路9号院7号楼1层101室
联系人	张晓宇
邮政编码	100094
互联网网址	http://www.bjkmt.com
电话	010-62611596
传真	010-62988180
电子邮箱	bjkmt@bjkmt.com
所属行业	公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）中的“C3985 电子专用材料制造”行业
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口；销售机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、塑料制品；机械设备租赁（不含汽车租赁）；生产高分子材料产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
本次证券发行类型	在北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票

四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系

（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况

截至本发行保荐书出具日，广发证券全资子公司广发乾和，直接持有发行人5,350,000股（对应发行前持股比例为4.45%），通过小米长江间接持有发行人0.026%的股份。小米长江的基金管理人为湖北小米长江产业投资基金管理有限公司，实际控制人为雷军，小米长江投资发行人系其独立做出投资决策，并非广发乾和主动对发行人进行投资。

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况

截至本发行保荐书出具日，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份（通过二级市场买卖广发证券及其重要关联方少量股票的情况除外），不存在影响保荐机构和保荐代表人公正履行保荐职责的情况。

（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况

截至本发行保荐书出具日，保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况。

（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况

截至本发行保荐书出具日，保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况。

（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系

截至本发行保荐书出具日，保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。

五、保荐机构内部审核程序和内核意见

（一）内部审核程序

根据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》及其他相关法律法规，本保荐机构制订了《投资银行业务立项规定》《投资银行业务质量控制管理办法》《投资银行业务问核工作规定》《投资银行类业务内核工作办法》等作为项目内部审核流程的常规制度指引。

1、立项

投资银行业务人员在发行保荐与承销项目的承揽过程中，根据收集到的资料，判断项目符合立项标准，且有相当把握与企业签署相关协议时，经投行业务部门负责人、分管投行委委员认可后，通过投行业务管理系统提出立项申请。立项申请人按照投行质量控制部的要求，提交立项申请报告和立项材料。立项申请受理后，投行质量控制部指定质量控制人员对材料进行预审。

项目组落实预审意见的相关问题后，投行质量控制部确定立项会议召开时间，将项目提交立项委员会审议，向包括立项委员、项目组成员在内的与会人员

发出立项会议通知，立项委员通过立项会议审议及表决确定项目是否通过立项。

2、质量控制部审核验收

申请材料首先由项目所在业务部门负责人组织部门力量审议，项目所在业务部门认为申请材料真实、准确、完整，无重大法律和财务问题的，经业务部门负责人、分管投行委委员等表示同意后，项目组通过投行业务管理系统申请质控审核验收。

投行质量控制部安排质量控制人员对项目进行审核，进行现场核查，对底稿进行验收。项目组认真落实投行质量控制部审核验收意见，并按要求补充尽职调查，完善工作底稿。

底稿验收通过后，投行质量控制部制作项目质量控制报告，列示项目存疑或需关注的问题提请内核会议讨论。

提交内核会议审议前，投行质量控制部组织和实施问核工作，形成书面或者电子文件记录，由问核人员和被问核人员确认，并提交内核会议。

3、内核会议审议

项目组完成符合内外部要求的尽职调查工作，投行质量控制部完成底稿验收及问核工作后，项目组向投行内核部申请启动内核会议审议程序。

投行内核部对按照要求提供完备材料的申请予以受理，指定内核初审人员对项目内核材料进行初审，提出内核初审意见。内核初审人员向投行业务内核委员会股权类证券发行专门委员会主任报告，由其确定内核会议的召开时间。投行内核部拟定参加当次内核会议并表决的内核委员名单，经批准后发出内核会议通知，组织召开内核会议，对项目进行审议。

内核会议结束后，投行内核部制作会议记录，明确会后需落实事项。项目组及时、逐项落实，补充、完善相应的尽职调查工作和信息披露事宜，收集相应的工作底稿，并提交书面回复。经投行质量控制部质量控制人员审查和投行内核部复核同意的，启动表决。

(二) 内核意见

本项目内核会议于 2025 年 5 月 9 日召开，内核委员共 9 人。2024 年 5 月 14 日，内核委员通过投行业务管理系统进行投票，表决结果：本项目通过内核。

本保荐机构认为，本项目符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件所规定的条件，同意推荐北京康美特科技股份有限公司本次证券发行上市。

第二节 保荐机构的承诺事项

一、本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会、北京证券交易所的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本证券发行保荐书。

二、本保荐机构已按照中国证监会、北京证券交易所的有关规定对发行人进行了充分的尽职调查，并对本次发行申请文件进行了审慎核查，本保荐机构承诺：

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会、北京证券交易所所有有关证券发行上市的相关规定；

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

9、自愿接受北京证券交易所的自律监管。

三、保荐机构及负责本次证券发行保荐工作的保荐代表人特别承诺

- 1、本保荐机构与发行人之间不存在未披露的关联关系；
- 2、本保荐机构及负责本次证券发行保荐工作的保荐代表人未通过本次证券发行保荐业务谋取任何不正当利益；
- 3、负责本次证券发行保荐工作的保荐代表人及其配偶未以任何名义或者方式持有发行人的股份。

第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见

一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论

本保荐机构认为：发行人本次发行符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《北交所公开发行股票注册办法》”）和《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《北交所上市规则》”）等法律、法规、政策规定的有关发行的条件，募集资金投向符合国家产业政策要求。为此，本保荐机构同意保荐发行人申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。

二、本次证券发行所履行的程序

（一）发行人董事会审议通过

2025年4月30日，发行人召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等关于本次发行上市的相关议案。

（二）发行人股东大会审议通过

2025年5月15日，发行人召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等关于本次发行上市的相关议案，并同意授权公司董事会办理与本次发行上市相关的具体事宜。

（三）本次发行取得批复情况

本次发行不存在需要取得国资委、国防科工局等外部审批的情况。

（四）发行人决策程序的合规性核查结论

本保荐机构认为，发行人本次发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会、北京证券交易所规定的决策程序。

三、本次证券发行符合规定的发行条件

（一）本次发行符合《证券法》规定的相关条件

保荐机构按照《证券法》第十二条规定的发行条件，对发行人是否符合要求进行了逐项核查，现说明如下：

1、发行人已按照《公司法》等法律法规的规定设立了股东会、董事会、监事会，选聘了独立董事，选举产生了职工监事，聘任了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，董事会设置了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等董事会专门委员会，建立了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间相互协调和相互制衡的机制，并制订或完善了公司治理文件和内控制度，具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第（一）项之规定。

2、根据保荐机构对发行人财务、税务等资料的核查，并根据申报会计师出具的标准无保留意见的审计报告，发行人财务状况良好，且具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第（二）项之规定。

3、发行人 2022 年度、2023 年度和 2024 年度的财务报表均被出具标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》第十二条第（三）项之规定。

4、根据保荐机构对发行人控股股东、实际控制人调查表、无犯罪证明和出具的承诺的核查，以及通过访谈、网络搜索等方式进行的核查，并根据发行人律师出具的法律意见书，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第（四）项之规定。

5、根据保荐机构对发行人的全面核查，发行人符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

本保荐机构认为，发行人本次发行符合《证券法》有关规定。

（二）本次发行符合《北交所公开发行注册办法》规定的发行条件

1、发行人于 2024 年 3 月 19 日在新三板创新层挂牌，已挂牌满一年，符合《北交所公开发行注册办法》第九条的规定。

2、保荐机构查阅了发行人的公司治理制度文件、公司组织架构图、报告期的三会召开文件、近三年的审计报告、取得公司的工商、税务等政府主管部门的无违规证明等。经核查，发行人具备健全且运行良好的组织机构；具有持续经营能力，财务状况良好，不存在对持续经营有重大不利影响的情形；最近三年财务会计报告无虚假记载，被出具标准无保留意见审计报告；依法规范经营，依法履行信息披露义务，符合《北交所公开发行注册办法》第十条的规定。

3、保荐机构查阅了企查查、中国裁判文书网、最高人民法院失信被执行人信息查询平台等；取得发行人政府主管部门的无违规证明、取得控股股东、实际控制人无犯罪记录证明等。

经核查，发行人符合《北交所公开发行注册办法》第十一条的规定，发行人及其控股股东、实际控制人不存在下列情形：

（1）最近三年内存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪；

（2）最近三年内存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；

（3）最近一年内受到中国证监会行政处罚。

本保荐机构认为，发行人本次发行符合《北交所公开发行注册办法》有关规定。

（三）本次发行符合《北交所上市规则》的上市条件

1、发行人于 2024 年 3 月 19 日在新三板创新层挂牌，已挂牌满一年，符合《北交所上市规则》2.1.2 第（一）项的规定。

2、本次证券发行符合《北交所公开发行注册办法》规定的发行条件，具体参见本发行保荐书“第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见”之“三、本次证券发行符合规定的发行条件”之“（二）本次发行符合《北交所公开发行注册办法》规定的发行条件”，符合《北交所上市规则》2.1.2 第（二）项的规定。

3、发行人 2024 年末归属于母公司的净资产 49,693.07 万元，不低于 5,000 万元，符合《北交所上市规则》2.1.2 第（三）项的规定。

4、公司本次公开发行的预计发行 2,121 万股（未行使超额配售选择权），或 2,439.15 万股（假定全额行使超额配售选择权），发行对象预计不少于 100 人，符合《北交所上市规则》2.1.2 第（四）项的规定。

5、公司本次公开发行前股本总额 12,020 万元，本次公开发行预计发行 2,121 万股，公开发行后，公司股本总额不少于 3,000 万元，符合《北交所上市规则》2.1.2 第（五）项的规定。

6、公开发行后，发行人股东人数预计不少于 200 人，公众股东持股比例预计不低于公司股本总额的 25%，符合《北交所上市规则》2.1.2 第（六）项的规定。

7、预计发行时公司市值不低于 2 亿元；2023 年度、2024 年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 4,192.27 万元、6,229.22 万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 9.47%、13.13%，适用《北交所上市规则》2.1.3 第（一）项的标准。发行人符合《北交所上市规则》2.1.2 第（七）项的要求。

8、发行人符合《北交所上市规则》2.1.2 第（八）项北交所规定的其他上市条件。

9、发行人及相关主体不存在以下情形，符合《北交所上市规则》2.1.4 的规定：

（1）最近 36 个月内，发行人及其控股股东、实际控制人，存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；

（2）最近 12 个月内，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会及其派出机构行政处罚，或因证券市场违法违规行为受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司、证券交易所等自律监管机构公开谴责；

（3）发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立

案调查，尚未有明确结论意见；

(4) 发行人及其控股股东、实际控制人被列入失信被执行人名单且情形尚未消除；

(5) 最近 36 个月内，未按照《证券法》和中国证监会的相关规定在每个会计年度结束之日起 4 个月内编制并披露年度报告，或者未在每个会计年度的上半年结束之日起 2 个月内编制并披露中期报告；

(6) 中国证监会和本所规定的，对发行人经营稳定性、直接面向市场独立持续经营的能力具有重大不利影响，或者存在发行人利益受到损害等其他情形。

10、本次发行上市无表决权差异安排，符合《北交所上市规则》第 2.1.5 的规定。

综上，发行人符合向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市条件。

四、发行人存在的主要风险

(一) 经营及技术风险

1、电子封装材料产品迭代及技术开发风险

发行人电子封装材料作为 LED 芯片封装的关键材料，对新型显示、半导体通用照明、半导体专用照明、半导体器件等应用产品性能产生直接影响。近年来，半导体通用照明产品逐步向高光效、高品质、低碳化方向发展，车用照明、智慧照明、植物照明、健康照明等多种半导体专用照明快速兴起，新型显示技术则向超薄化、大屏化、超清显示方向持续演进。在此背景下，LED 封装技术呈现高光效、微间距、超薄化的技术发展趋势，新型封装技术路线持续丰富，对上游电子封装材料提出了更高的性能要求，下游封装厂商在选择封装材料供应商时执行更为严苛的考核验证程序。未来，若发行人不能准确地把握下游行业的发展趋势，研发响应速度、核心技术储备无法满足下游客户持续发展的应用需求，或在与竞争对手的直接技术竞争中处于劣势，将对发行人核心竞争力造成不利影响。

2、核心技术泄密风险

发行人所处高分子新材料行业属于典型的技术密集型行业，研发创新能力是

支撑企业持续发展的基础。公司已围绕有机硅封装材料、环氧封装材料及改性可发性聚苯乙烯材料三大技术平台搭建了全面的核心技术体系。若在生产经营过程中，公司重要技术研发成果或技术秘密被不当泄露，将对公司生产经营及保持核心竞争力产生不利影响。

3、关键技术人员流失风险

关键技术人员是企业维持竞争力的重要因素。公司已建立一支拥有高分子新材料专业背景及丰富的产业化研发经验的技术团队，截至 2024 年 12 月 31 日，公司研发团队共 57 人，研发人员占总人数的比例为 18.27%。随着我国高分子新材料行业的持续发展，对于拥有丰富经验的关键技术人才的争抢不断加剧。未来，如公司薪酬水平与同行业竞争对手相比丧失竞争优势，或内部晋升、激励制度得不到有效执行，公司或将无法引进更多的高端技术人才，甚至可能出现有关键技术人员流失的情形，从而影响公司技术研发和产品升级，对公司保持市场竞争力产生不利影响。

4、业务规模快速增长带来的管理风险

报告期内，发行人业务规模持续扩张，电子封装材料及高性能改性塑料产品布局不断丰富、下游应用领域持续拓宽。公司组织架构日益庞大、管理链条逐步延长，生产经营基地分布在北京市、上海市、广东省深圳市、河北省沧州市等地。

若公司本次发行成功，募集资金到位、募投项目实施后，公司资产规模将迅速增加、产销规模进一步提高，从而在资源整合、科技创新、资本运作、市场开拓等方面对公司的管理层和内部管理水平提出更高的要求。如果公司管理层业务素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能及时调整、完善，则公司将面临较大的管理风险。

（二）财务风险

1、应收账款、应收票据及应收款项融资余额较大的风险

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 10,070.94 万元、11,377.64 万元和 13,800.02 万元，占资产总额比例分别为 18.42%、19.95%和 23.18%；公司应收票据及应收款项融资合计账面价值分别为 5,101.36 万元、7,289.19 万元和 8,289.68 万元，占资产总额比例分别为 9.33%、12.78%和 13.92%。未来随着公司

营业收入的快速增长，应收账款、应收票据及应收款项融资余额将持续增加。若公司未能对应收账款、应收票据及应收款项融资实施高效管理，或客户信用状况发生恶化，致使相关款项不能按期回收或无法回收，则可能导致公司营运资金紧张，并对公司经营业绩产生不利影响。

2、存货跌价风险

公司存货主要包括原材料、半成品、在产品、库存商品、发出商品，报告期各期末，公司存货的账面余额分别为 5,003.32 万元、6,815.87 万元和 7,213.87 万元，存货跌价准备分别为 269.40 万元、349.57 万元和 609.24 万元。在未来经营中，若出现原材料价格上涨、人工成本增加、客户需求变更、履约期限延长等因素导致产品制造成本提高，或出现新产品推出计划延后或取消、市场环境巨变等因素导致订单无法按约履行等情况，将存在存货跌价准备进一步增加的可能性，并将对公司盈利能力造成不利影响。

3、税收优惠政策变化的风险

报告期内，发行人、子公司上海康美特 2022 年度至 2024 年度享受 15% 的高新技术企业所得税优惠税率，子公司天津斯坦利 2022 年至 2023 年享受 15% 的高新技术企业所得税优惠税率，子公司深圳康美特 2022 年度享受小微企业普惠性税收减免政策、2022 年度至 2024 年度享受小微企业所得税优惠。如果国家有关税收优惠的法律、法规、政策等发生重大调整，或者由于公司未来不能持续取得高新技术企业资格或不满足其他相关税收优惠条件等，将对公司的经营业绩造成一定不利影响。

（三）内部控制及法律风险

1、实际控制人持股比例较低的风险

公司实际控制人葛世立直接持有公司 11.10% 的股份，通过康美特技术控制公司 27.49% 的股份，合计控制公司 38.59% 的股份。公司存在实际控制人拥有表决权比例较低，从而产生决策效率降低的风险，可能对公司的业务开展产生不利影响。

2、知识产权纠纷风险

高分子新材料行业属于技术密集型行业，涉及的知识产权数量众多。发行人一直高度重视自主知识产权的研发及保护工作，通过自主研发在配方工艺及生产工艺等方面先后形成了多项核心技术，部分核心技术已通过申请专利进行保护，但是仍然无法避免竞争对手或其他利益相关方通过模仿窃取公司的知识产权或者对公司进行恶意诉讼，进而影响公司正常的生产经营开展。

3、环境保护方面的风险

随着我国经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，国家对环保的要求越来越高，公司生产过程中会产生废气、废水和固体废弃物。如果公司的环保设施运转发生故障，或者公司的后续环保支出投入不足，可能导致公司发生环境污染的风险增加。

此外，如果政府颁布新的法律法规，提高环保标准和规范，公司需要加大环保投入，从而导致生产经营成本提高，可能影响公司的经营业绩。

（四）募集资金投资项目风险

1、募集资金投资项目无法顺利实施的风险

公司本次募集资金投资项目为“半导体封装材料产业化项目（有机硅封装材料）”，拟建设年产 1,000 吨有机硅封装材料生产线。尽管上述项目是公司基于现有技术储备、经营状况和未来发展战略等因素赋予实施的，若未来项目实施过程中，经营环境、下游市场需求、行业技术迭代等客观条件发生较大不利变化，或者发生其他不可预见因素等导致项目延期或无法顺利实施，将对公司生产经营和业绩造成不利影响。

2、募集资金投资项目效益无法达到预期的风险

本次募集资金投资项目投产后，公司固定资产、无形资产将大幅增加，新增折旧、摊销费用较大，公司能否顺利开拓市场并有效消化新增产能将直接影响募集资金项目的收益实现及公司整体业绩。尽管公司募集资金投资项目系基于产品未来市场需求、自身技术水平、市场竞争格局等因素充分论证后提出的，但仍可能出现项目实施后，由于国内外宏观经济形势变化、下游市场容量变化、市场竞

争激烈程度变化等因素而导致的产品销售未达预期目标，从而对募集资金投资项目的投资效益和公司的经营业绩产生不利影响。

（五）行业风险

1、行业波动及下游领域政策变化风险

公司电子封装材料行业属于电子制造业的上游关键支撑行业，其需求受通用照明、专用照明、消费电子、汽车电子等终端消费场景景气度影响较大。未来，若 Mini/Micro LED、全彩 LED 直显等新型显示、专用照明市场增长放缓，公司可能将面临业绩增长受阻或出现下滑的风险。

公司高性能改性塑料应用于头部安全防护、易损件防护、建筑节能等领域，与宏观经济及国民消费景气度紧密联系。应用于建筑节能的高热阻改性聚苯乙烯，还与居民住宅、商用建筑等房地产建筑行业存在着高度的关联性。报告期内，我国房地产市场深度调整，作为建筑节能材料，公司高热阻改性聚苯乙烯产品需求受到一定扰动。未来一段时间，若我国房地场景气度持续处于低位，可能对公司高热阻改性聚苯乙烯产品销售情况产生一定不利影响。

2、市场竞争风险

电子封装材料业务方面，公司与美国杜邦、日本信越、日本稻畑等国际知名厂商直接展开竞争，上述国际知名厂商发展起步较早，研发创新能力优势显著，并已建立覆盖全球的市场推广体系，取得了下游客户的广泛认可。发行人历经多年发展，已实现了较为完备的研产销体系搭建，在技术先进性、产品丰富度、质量稳定性方面持续突破，但在整体业务规模、品牌影响力等方面与国际厂商尚存一定差距。同时，在相关产业政策支持下，国内胶粘剂厂商逐步向产业链高端迈进，公司电子封装材料领域国内竞争对手可能进一步增加。未来，若公司不能紧跟市场发展趋势，在技术研发、客户服务等方面进一步巩固市场竞争力，则可能面临市场竞争加剧的风险，对公司业绩增长产生不利影响。

高抗冲改性聚苯乙烯材料方面，公司与美国 Polysource、日本积水、努发化学等国际知名企业展开直接竞争，上述企业在细分领域深耕多年，具有较强的市场地位，综合竞争实力强大。与之相比，公司虽已实现产品技术的快速突破并已进入众多知名下游客户供应链，但在产能规模、品牌推广及销售网络覆盖方面仍

存在较大差距。未来，面对国际知名企业的竞争压力，同时伴随本土竞争对手日渐加入市场，若公司不能及时把握市场动态，快速提升市场份额，则可能面临产品销量增速不及预期等市场竞争风险。

高热阻改性聚苯乙烯作为传统建筑节能材料的高性能替代产品，在“双碳”政策推行、建筑节能标准不断提升的背景下，市场前景广阔，吸引传统可发性聚苯乙烯材料厂商通过引进国外产品配方、工艺设备等方式逐步加入市场竞争行列。上述市场新进者在技术先进性、技术自主可控性、产品质量稳定性方面仍较为欠缺，导致当前市场存在产品质量良莠不齐、市场竞争无序的情况。未来，若产品质量标准未能及时统一，强有力的市场监管措施未能及时实施，公司可能面临市场竞争加剧风险，对公司盈利能力、业绩增长产生不利影响。

3、原材料价格波动和供应风险

公司电子封装材料产品主要原材料包含各类硅烷，环氧树脂等基体树脂，二氧化硅、银粉等粉体类材料，催化剂、抑制剂等助剂，大多属于精细化工行业的下游产品；高性能改性塑料产品主要原材料包含通用级聚苯乙烯（GPPS）、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）及发泡剂、阻燃剂、石墨、聚乙烯等改性助剂，大多属于石油化工行业的下游产品。报告期内，公司直接材料成本占主营业务成本的比例分别为 84.99%、80.24% 和 80.15%，占比相对较高，因此原材料价格波动将直接影响公司产品的生产成本，可能导致毛利率下滑。

假设报告期内公司销售价格保持不变，主营业务成本中的直接材料成本分别变动±10%、±30%、±50%，对主营业务毛利率影响的测算如下：

原材料成本变动幅度	主营业务毛利率变动百分点		
	2024 年度	2023 年度	2022 年度
10.00%	-4.89	-5.12	-5.86
-10.00%	4.89	5.12	5.86
30.00%	-14.68	-15.36	-17.57
-30.00%	14.68	15.36	17.57
50.00%	-24.47	-25.61	-29.29
-50.00%	24.47	25.61	29.29

根据测算，2024 年度原材料价格每波动 10% 对公司主营业务毛利率的影响为 4.89 个百分点，每波动 30% 对公司主营业务毛利率的影响为 14.68 个百分点，

每波动 50% 对公司主营业务毛利率的影响为 24.47 个百分点。

未来若原材料价格继续下滑，公司为加强产品竞争力和有效维护客户关系，可能根据市场行情下调产品的销售价格，则公司产品销售价格存在下降的风险，进而对公司经营业绩造成不利影响。

4、Mini/Micro LED 等新兴应用领域发展不及预期风险

近年来，新型显示领域技术快速发展，Mini/Micro LED 作为新一代主流显示技术，产业化进程进入加速期，知名 LED 封装厂商及终端消费电子厂商已进行大规模资本投入。2018 年以来，公司率先布局 Mini LED 领域，成功推出多款 Mini LED 有机硅封装胶产品，并持续投入 Mini LED 直显应用领域产品研发。2021 年以来，随着 Mini LED 背光技术实现大规模商业化应用，公司 Mini LED 有机硅封装胶产品同步导入量产应用。目前在液晶（LCD）显示、OLED、小间距全彩 LED 直显等多种新型显示技术并存的市场环境中，若 Mini LED 市场渗透率及市场规模增长不及预期或 OLED 等技术的进一步突破并对 Mini LED 逐步替代，可能对公司业务开展造成不利影响。

同时，为保证技术创新水平，取得市场、技术先发优势，公司将向 Micro LED 应用领域拓展产品研发。Micro LED 显示技术虽在各项显示指标方面都能够达到极佳效果，但目前其在芯片制作、巨量转移、检测修复等领域尚有技术问题亟待解决。如果公司未来不能及时准确把握 Micro LED 商业化应用发展趋势和技术升级节奏，不能合理的进行研发投入，或对于 Micro LED 应用产品的投入无法及时、有效转化为可落地成果，则可能出现技术创新无法及时产业化的风险，进而影响公司经营战略的实施。

（六）其他风险

1、摊薄即期回报的风险

本次公开发行募集资金到位后，公司净资产规模和总股本规模将有所提高。由于募投项目实现预期利润尚需要一定时间，导致短期内公司的每股收益和净资产收益率存在被摊薄的风险。此外，若本次发行募集资金不能实现预期效益，也将可能导致公司的每股收益和净资产收益率被摊薄，从而降低公司的股东回报。

2、股票价格可能发生较大波动的风险

本次发行后，除受公司生产经营和财务状况影响外，公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响而发生波动。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

五、对发行人发展前景的评价

（一）发行人主营业务情况

公司主要从事电子封装材料及高性能改性塑料等高分子新材料产品的研发、生产、销售。自设立以来，公司坚持以研发驱动业务发展，围绕有机硅封装材料、环氧封装材料及改性可发性聚苯乙烯材料三大技术平台持续进行技术突破和产业化。公司电子封装材料的主要产品形态为 LED 芯片封装用电子胶粘剂，广泛应用于新型显示、半导体照明、半导体器件封装及航空航天等领域。公司高性能改性塑料的产品形态为改性可发性聚苯乙烯，广泛应用于运动及交通领域头部安全防护、液晶面板及锂电池等易损件防护以及建筑节能等领域。

目前，公司已建立完整的研发、生产体系并拥有完全自主知识产权。截至报告期末，公司拥有已获授权发明专利 36 项，实用新型专利 57 项。近年来，凭借强大的技术实力，公司先后承担、参与多项国家级、省级重大科研项目，作为课题承担单位承担了“十四五”国家重点研发计划重点专项“耐深紫外、高透光率 LED 封装胶的研制”课题，参与了“超高能效半导体光源核心材料及器件技术研究”及“第三代半导体核心配套材料”两项“十三五”国家重点研发计划重点专项项目，参与工信部“家电智能控制器绿色制造关键工艺系统集成项目”，并作为课题承担单位独立承担了北京市科技计划“太阳能光伏组件有机硅封装材料的产业化”课题。此外，公司两项产品入选北京市重点新材料首批次应用示范指导目录。公司曾入选建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业名单（第二批），为北京市专精特新中小企业、北京市市级企业技术中心；子公司上海康美特为上海市专精特新中小企业；子公司天津斯坦利曾入选国家级专精特新“小巨人”企业名单（第三批），曾荣获天津市“瞪羚企业”、天津市“科技领军培育企业”等称号。

（二）公司所处行业具有良好的发展前景

1、电子封装材料

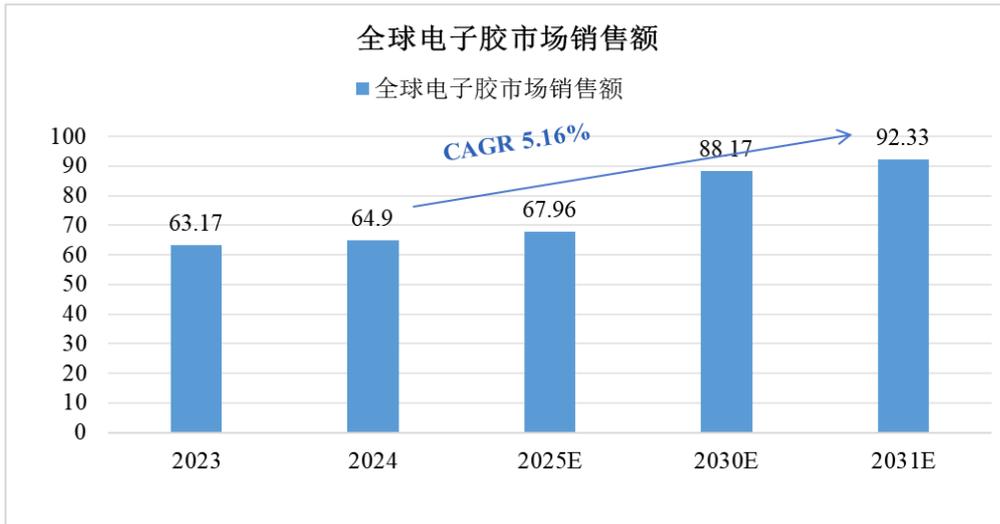
（1）电子封装材料是电子制造业的重要支撑产业

电子封装材料产业是电子元器件、电子电器制造产业链的重要支撑产业，在电子材料中占据重要地位，是推动封装技术演进、电子元器件性能持续提升的重要驱动。电子封装材料及电子胶粘剂在电子产业链中的位置图示如下：



（2）受益于下游及终端应用领域的快速发展，电子胶粘剂市场近年来展现出强劲的增长态势

电子胶粘剂主要为应用于电子电器粘接、封装的胶粘剂产品。受益于下游及终端应用领域的快速发展，电子胶粘剂市场近年来展现出强劲的增长态势。根据 QYResearch 数据，2024 年全球电子胶市场销售额达 64.9 亿美元，同比增长 2.74%，预计 2031 年有望达到 92.33 亿美元，2024 年至 2031 年复合增长率预计为 5.16%。



数据来源：QYResearch

根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会杨栩秘书长于“2022 年中国（大湾区）电子胶粘剂技术发展高峰论坛”的发言，近年来，在 5G 建设、消费电子、新能源汽车、家用电器及装配制造业等新兴消费市场的驱动下，我国电子胶粘剂市场迅猛发展，市场已超 100 亿元规模，成为增长速度最快、发展潜力巨大的胶粘剂细分市场之一。根据 QYResearch 数据，2023 年中国电子胶市场规模达 16.37 亿美元，占据全球市场约 25.92% 的份额，预计 2030 年市场规模将增至 26.15 亿美元，全球市场占比将达 29.65%。

（3）我国高端电子胶粘剂领域仍由国际知名厂商所主导，国产化提升空间大

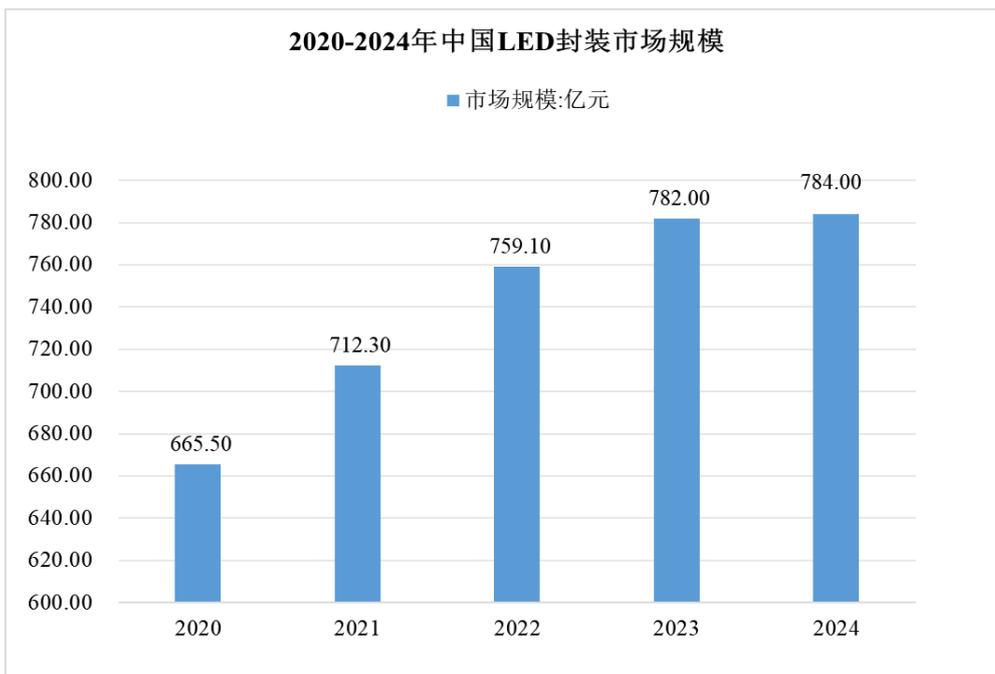
电子封装材料方面，美国杜邦、日本信越、日本稻畑等国际大型化工企业深耕行业多年，在技术研发方面占据明显优势。2010 年以来，半导体、新型显示及智能终端等产业加速向国内转移，鉴于成本控制、供应便利、自主可控需求等多方面因素，电子封装材料国产化需求十分强烈。近年来，国内厂商逐步启动相关产品研发，在中低端电子封装材料领域已基本实现国产化。但与国际厂商相比，目前大部分国内厂商在高端电子封装材料的产品性能、质量稳定性及产品储备丰富度方面仍存在较大差距。

根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会统计数据，国内电子胶粘剂国产化程度不高，国产化发展空间较大。历经多年发展，我国企业在中低端的元器件及成品电路板的灌封、密封用电子胶粘剂市场中具有较高的性价比优势，已占据一定的市

场份额。但对技术、工艺要求较高的部分 PCB 板级封装、晶圆级封装、半导体芯片封装用高端电子胶粘剂领域仍由国际知名厂商所主导，国内厂商多处于产品导入阶段，仅少部分企业实现了对主流下游客户的批量供货，国产化提升方面仍有较大的发展空间。

(4) Mini LED 等新型 LED 封装技术为 LED 芯片封装用电子胶粘剂行业带来发展新动能

受益于政策大力支持、电子产业链向我国快速转移等因素，我国已逐步成为全球 LED 封装的主要基地，封装技术水平逐步提升。根据中商产业研究院及 CSA Research 数据，2020 年至 2024 年，我国 LED 封装市场规模由 665.50 亿元增至 784 亿元。随着小间距全彩 LED 直显技术、Mini/Micro LED 技术等新型 LED 封装技术逐步导入商业化量产，LED 封装产业及产业链上下游投资进程加快，为应用于 LED 芯片封装的电子封装材料市场注入了新的活力。



数据来源：中商产业研究院、CSA Research

2、高性能改性塑料行业发展概况

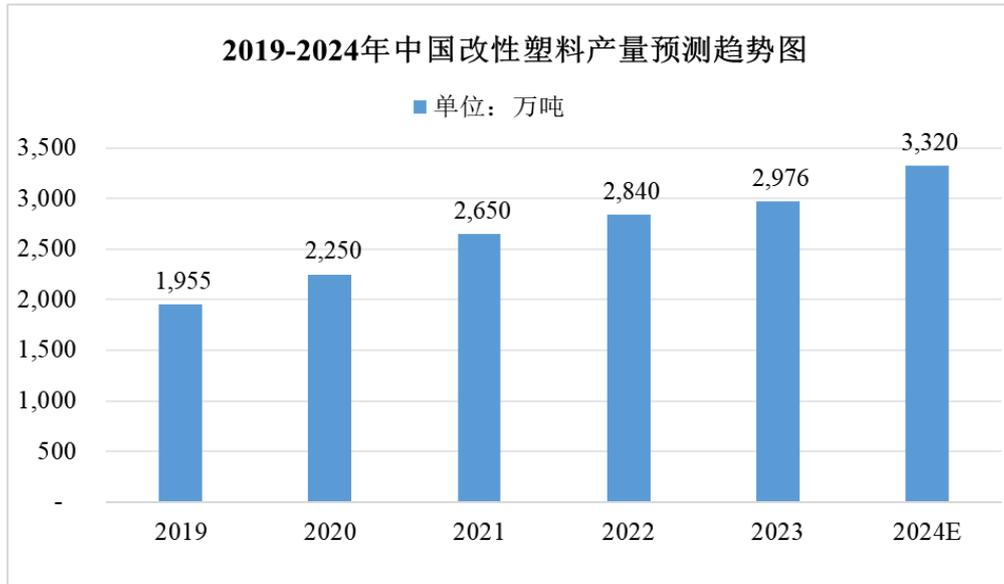
塑料制品作为合成高分子材料，具有质量轻、强度高、绝缘、透光、耐磨等特性，广泛应用于人类社会的各项生产活动。但塑料本身存在着耐热性差、热膨胀系数大、易燃、低温下变脆、易老化等问题，对于汽车、轨道交通、电子电器、医疗健康等对材料性能要求较高的行业，绝大多数塑料制品难以直接用于下游产

品的加工制造，必须经塑料改性以满足不同性能要求。随着应用领域不断拓宽，改性塑料技术随之得到快速发展。

塑料改性以五大通用塑料、五大工程塑料及特种工程塑料为基材，加入特定添加剂，通过物理、化学改性技术或二者相结合的方式使塑料材料具有新颖结构特征。改性塑料在克服传统塑料制品的刚性、韧性不足，受热变形等性能缺陷的同时可兼具阻热、阻燃、抗静电、抗菌等特殊性能。经过多年发展，在广阔的塑料制品市场占据重要位置，深入研究聚合物组成、结构和性能的关系，并在此基础上对塑料进行改性已成为塑料工业的重要发展方向。改性塑料在产业链中的位置如下图所示：



根据华经产业研究院数据，2023年全球改性塑料市场规模约为4,285亿美元，同比上升4.6%，北美仍是全球最大的改性塑料市场，市场规模占比达32.1%，其次是欧盟和亚洲。我国改性塑料行业发展起步较晚。20世纪90年代，伴随“以塑代钢”“以塑代木”理念推行，我国塑料产量维持稳定增长，改性塑料工业体系逐步完善，相关设备及技术持续发展。近年来，我国各类终端工业产品轻量化、定制化、环保化趋势显著，汽车、家电等下游行业快速发展，国内改性塑料产量及需求量保持快速增长推动改性塑料市场扩张。根据前瞻产业研究院数据，我国塑料改性化率已由2010年约16%提升至2023年约25%，但相比全球塑料改性化率50%的平均水平仍有较大提升空间。近年来，在相关政策的大力支持下，我国改性塑料市场已实现大幅增长。根据中商产业研究院数据，2019-2023年，我国改性塑料产量由1,955万吨增长至2,975.5万吨，年复合增长率达11%，2024年预计产量为3,320万吨。



数据来源：中商产业研究院

（三）发行人具备较强的市场地位及竞争优势

1、发行人市场地位

（1）电子封装材料

电子封装材料方面，公司高折射率有机硅封装胶、常规折射率有机硅封装胶、电子环氧封装胶、LED 环氧模塑料产品主要用于 LED 芯片的包封、塑封，有机硅固晶胶、导电银胶产品主要用于 LED 芯片及半导体芯片的固晶。目前，公司电子封装材料产品性能已达到与美国杜邦、日本信越、日本稻畑等国际知名厂商相当水平，在我国 LED 芯片封装用电子胶粘剂领域处于领先地位。

公司已成为国内率先实现 Mini LED 有机硅封装胶量产的厂商，成功进入京东方、TCL 科技、海信等多家行业领先客户供应链，与美国杜邦等国际厂商展开直接竞争。根据北京第三代半导体产业技术创新战略联盟 2022 年出具的《科学技术成果评价报告》，公司自主研发的光学级有机硅封装材料制备技术及其在 LED 领域的应用实现了我国 LED 有机硅封装胶产品的规模化生产，率先实现了 Mini LED 新型显示封装材料产业化，产品技术整体达到国际先进水平，有力推动了我国 LED 产业的发展。

（2）高性能改性塑料

1) 高抗冲改性聚苯乙烯

①超轻抗冲防护材料

由于其严格的抗冲击性能要求，专业运动及交通领域头部安全防护材料市场长期被美国 Polysource 等国际厂商所占据。公司通过对连续挤出法生产工艺及配方设计的精准把控，实现了条形及球形超轻抗冲防护材料的稳定生产。根据中国轻工业联合会 2022 年出具的《科学技术成果鉴定证书》，公司超轻抗冲防护材料及其连续挤出法生产技术整体达到国际先进水平，成功实现国产化。目前，公司已成为国内率先实现超轻抗冲防护材料稳定生产的厂商，产品质量及技术水平处于国内领先地位。

② 烯烃增韧防护材料

根据中国塑料加工工业协会 EPS 专委会出具的说明，目前国内仅极少数企业具备同类材料的批量生产能力，公司处于该细分市场国内领先地位。此外，烯烃增韧防护材料可在各类模具中进行发泡，形成不同形状的、适用于各类精密器件生产周转及销售运输过程中的防护材料，下游应用领域有望持续拓展。

2) 高热阻改性聚苯乙烯

公司为我国率先在配方设计及生产工艺方面拥有自主知识产权并实现石墨改性可发性聚苯乙烯稳定生产的厂商。根据中国轻工业联合会 2018 年出具的《科学技术成果鉴定证书》，公司高热阻改性聚苯乙烯的连续挤出法生产工艺达到国际先进水平。公司高热阻改性聚苯乙烯阻热性能优异，同时具有高阻燃性、高熔接性、高抗压强度、高抗拉强度、低吸水性等特点，产品主要技术指标与国际知名厂商对标产品相当，在国内市场具有领先地位。

2、发行人竞争优势

(1) 发行人具备领先的高分子新材料技术优势

公司多年来围绕有机硅封装材料、环氧封装材料及改性可发性聚苯乙烯材料三大高分子材料技术平台不断深耕，通过自主研发形成了独具特色的核心技术体系。截至报告期末，公司拥有已获授权发明专利 36 项，其中境内 29 项，中国港澳台地区及境外 7 项；拥有境内实用新型专利 57 项，参与起草行业标准 2 项。

电子封装材料方面，公司全面掌握了配方核心成分设计及合成技术、光学胶粘剂产品配方开发技术及电子封装材料关键工艺，核心技术自主可控并持续创新。通过上述技术的运用，公司产品的光学性能、可靠性、工艺操作性及稳定性

持续突破；根据不同客户的综合应用性能需求，实现了各类性能间的平衡兼容。凭借领先的电子封装材料技术优势，公司先后承担和参与多项国家级、省级重大科研项目。

高性能改性塑料方面，公司全面掌握了连续挤出法可发性聚苯乙烯产品配方设计及“超临界”状态下聚苯乙烯、发泡剂及各类助剂的均相混合、物理发泡剂预发泡控制技术的关键工艺技术，同时针对可发性聚苯乙烯材料特性，在阻热、阻燃、增韧、高抗冲等改性技术方面持续进行突破，形成多项自主可控核心技术，拥有多项专利技术和专有技术秘密。凭借先进的高性能改性塑料技术优势，公司先后荣获“天津市科技进步奖三等奖”、中国轻工业联合会“科学技术发明三等奖”、中国塑料加工工业协会“优秀科技成果奖”、中国塑料加工工业协会“科技创新型优秀会员单位”“第八届中国创新创业大赛优秀企业”等诸多荣誉。

（2）发行人具备突出的研发创新优势

公司自设立以来坚持以研发驱动业务发展，以下游应用领域前沿技术发展及材料需求变化为导向，针对研发及产业化的关键技术瓶颈不断实现突破，拥有灵活快速的研发响应能力，有效开展持续性的创新布局。

公司高度重视研发团队建设，不断充实人才队伍，打造了一支兼具深厚专业背景及丰富的新材料产业化经验的研发团队。公司研发团队由多位曾在中科院化学所及其下属单位从事高分子材料研究及产业化的核心技术人员领衔，专业背景涵盖高分子材料、化学工程、机械工程等，研发团队结构合理、技能全面，形成了坚实的技术人才壁垒，有力地支撑了公司的技术创新和产品研发。截至 2024 年 12 月 31 日，公司研发团队共 57 人，占公司总人数的比例为 18.27%。目前，公司已建立全面的人才引进、人才培养制度及具有吸引力的研发激励制度，保证源源不断的人才供给和内部人员的能力提升，为持续构建高效、高素质的研发团队提供了有力保障。

公司基于研发经验逐步搭建形成了与公司核心技术体系、研发过程所需资源相匹配的研发机构设置，为公司保持研发创新优势奠定了基础。公司设有研发中心，各部门专注不同类型电子封装材料及高性能改性塑料的前沿技术追踪及应用产品研发。同时，公司积极与高等院校等研究机构开展产学研合作，有效组织和

运用科研资源服务企业技术创新。

（3）发行人具备产品储备及产品定位优势

公司电子封装材料产品定位高端，主要对标国际知名厂商有机硅及环氧封装材料，产品作为精密电子器件的关键辅助性材料，用量虽小但对终端产品性能有着重要影响，下游封装客户一般选择一至两家供应商作为主要供应商，以便管理并保证材料的稳定性。近年来，公司紧密跟踪封装技术发展动态及应用领域产品性能需求变化，逐步构建了全面且具有前沿性的产品布局，实现了对 SMD、POB、COB、CSP 及 MIP 等 LED 芯片封装形式的全面覆盖，电子封装材料型号达数百款。针对 Mini LED 等前沿应用领域，公司率先进行前瞻性产业布局，多款 Mini LED 有机硅封装胶产品现已通过客户验证实现大批量供货，进一步巩固了产品先发优势。同时，公司拥有多个有望大规模产业化的先进技术产品，储备产品主要包括 IGBT 有机硅封装胶、太阳能电池组件用有机硅封装胶、有机硅模塑料（SMC）等先进半导体、新能源封装材料，产品布局有望进一步拓展。

高性能改性塑料产品方面，公司持续开展改性技术开发，向各细分领域具有强烈国产化需求的高端产品不断发起冲击。公司高性能改性塑料产品以连续挤出法可发性聚苯乙烯制备工艺为核心，通过综合运用自主研发的针对性改性技术，逐个突破高热阻改性聚苯乙烯、球形超轻抗冲防护材料、条形超轻抗冲防护材料及烯炔增韧防护材料的技术难点，率先实现国产化，并形成了具有协同互补效应的产品布局。

（4）发行人已累积显著的客户资源优势

优质、稳定的客户资源是高分子新材料企业实现持续创新、稳定经营的重要保障。电子封装材料下游客户对产品性能指标、质量稳定性有着极为严苛的要求，通过验证测试并进入合格供应商名录具有较高门槛。此外，电子封装材料下游应用领域技术发展迅速，公司需持续进行研发响应、丰富产品储备、提升产品性能，并进行个性化开发服务，才能持续满足下游客户需求，维持长久、稳定的合作关系。经过多年市场开拓及品牌建设，公司凭借领先的技术实力、稳定的产品质量及丰富的产品储备，在与国际知名厂商的直接竞争中逐步扩大市场认可度，与主流下游客户建立了长期稳定的合作关系。公司客户群体已覆盖全球头部 LED 封

装厂商中的欧司朗、亿光电子、Dominant、首尔半导体、Lumileds 及国内头部企业鸿利智汇、国星光电、瑞丰光电、木林森、聚飞光电、三安光电、山西高科等，并已成功进入 TCL 科技、海信、京东方、小米、比亚迪、创维等知名终端厂商供应链。

高性能改性塑料方面，公司产品性能及稳定性通常需要在珠粒发泡成型并短期存放后进行验证。产品性能如不满足需求或质量发生波动，下游客户将面临大规模损失。因此，知名客户通常会对原材料厂商进行较长周期的质量验证。与头部下游企业的长期稳定合作能够帮助公司获取大量终端产品测试、实验数据，促进技术、产品更新迭代，且有助于取得客户新产品定制开发机会，进一步巩固技术先发优势。同时，优质的客户资源有利于公司提升市场声誉，持续扩大市场份额。目前，公司高抗冲改性聚苯乙烯中的超轻抗冲防护材料实现了对美联、韬略、信诺等国内知名厂商的大批量销售，高抗冲改性聚苯乙烯中的烯烃增韧材料在较短时间内已进入京东方、亿纬锂能等知名电子电器领域客户供应链。

（5）发行人在产品质量控制方面具备优势

高分子新材料产品作为产业链上游原材料，产品性能、质量稳定性对于下游产品品质有着重要影响，质量必须加以严格控制。公司高度重视产品质量管理工作，严格按照相关法律法规、标准建立了完善的质量管理体系，涵盖研发、采购、生产、检验和销售等各个环节。

目前，公司已通过 ISO 9001 质量管理体系认证；子公司天津斯坦利已通过 ISO 9001 质量管理体系认证；子公司上海康美特已通过 ISO 9001 质量管理体系认证、环境管理体系认证及 IATF 16949 汽车行业质量管理体系认证；子公司沧州康美特已通过 ISO 9001 质量管理体系认证。公司制定并严格执行了质量控制相关内控制度，确保产品质量的有效控制。

六、其他需要说明的事项

（一）有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见

1、保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查

（1）聘请的必要性

为降低保荐风险，提高申报材料质量，广发证券保荐的 IPO 项目在内核时聘请外部专业顾问（以下简称外聘顾问）提供专业意见。

（2）第三方的基本情况、资质资格、具体服务内容

康美特项目外聘顾问为张晓彤律师和何海燕会计师。

张晓彤，男，现就职于北京市通商律师事务所，合伙人律师，法学学士，1995 年取得中国律师执业资格，2014 年 10 月起被广发证券聘任为 IPO 项目专业顾问。

何海燕，女，现就职于中汇会计师事务所（特殊普通合伙），合伙人，注册会计师。2010 年取得中国注册会计师资质。2023 年 2 月起被广发证券聘任为 IPO 项目专业顾问。

（3）定价方式、实际支付费用、支付方式和资金来源

对于外聘顾问出具书面审核意见的项目，广发证券按照税前 25,000 元/项目/人次的标准支付报酬，并在项目内核工作结束后的次月扣除代扣代缴税费后支付，资金来源为广发证券自有资金。

2、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查

保荐机构对发行人有偿聘请第三方等相关行为进行了专项核查。经核查，发行人在本次发行上市中聘请广发证券担任保荐机构、主承销商，聘请康达律师担任发行人律师，聘请容诚会计师担任审计机构外，还聘请了环评咨询机构，具体如下

（1）聘请的必要性

发行人募投项目中的半导体封装材料产业化项目涉及环境影响评价及相关审批，因此聘请环评咨询机构提供相关服务。

（2）第三方的基本情况、资质资格、具体服务内容

河北朴质环境工程技术有限公司成立于 2004 年，注册地址为保定市朝阳北大街 1178 号朝阳龙座 1-302、1-305、1-306、1-309，法定代表人为韩进文，经营范围包括：环境影响评价；环境工程、中水回用工程设计；环保设备安装，环保技术咨询；环保产品技术开发（非研制），环保技术转让；环保产品、橡胶制品、塑料制品、五金产品、金属制品、木质活性炭、煤质活性炭、非金属矿及制品、

环境污染处理专用药剂材料销售(以上均不含危险化学品及易燃易爆品无储存);环保工程专业承包;环境污染治理设施运营;机电设备安装服务;环保工程服务;软件开发技术咨询服务;排污咨询及评估服务;通用设备、专用设备、仪器仪表销售、修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。该公司接受发行人之委托,提供半导体封装材料产业化项目环境影响报告书的编制服务。

(3) 定价方式、实际支付费用、支付方式和资金来源

经双方协商,河北朴质环境工程技术有限公司本次服务费用为 158,000 元(含税),支付方式为银行转账,资金来源为发行人自有资金。截至本发行保荐书出具日,上述费用已全部支付完毕。

3、核查结论

经核查,保荐机构认为,在本次发行上市项目中,广发证券除在内核时聘请何海燕和张晓彤担任外聘顾问外,不存在直接或间接有偿聘请其他第三方证券服务机构的行为。发行人在本次发行上市中除聘请广发证券担任保荐机构、主承销商,聘请康达律师担任发行人律师,聘请容诚会计师担任审计机构等依法需要聘请的机构,聘请河北朴质环境工程技术有限公司担任募集资金投资项目环评咨询机构外,不存在直接或间接有偿聘请其他第三方证券服务机构的行为,符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》([2018]22 号)的相关规定。

(二) 关于发行人财务报告审计截止日后经营状况的核查结论

保荐机构对发行人财务报告审计截止日(2024 年 12 月 31 日)后至本发行保荐书出具日的主要经营状况进行了核查。经核查,本保荐机构认为:财务报告审计截止日后至本发行保荐书出具日,发行人的经营模式未发生重大变化;主要客户的构成保持稳定,未发生重大不利变化;行业政策保持稳定,未发生重大不利变化;不存在其他可能影响投资者判断的重大事项。

附件: 保荐代表人专项授权书

(本页无正文,专用于《广发证券股份有限公司关于北京康美特科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之发行保荐书》之签字盖章页)

项目协办人: 曲可昕

曲可昕

保荐代表人: 哈馨 李英杰

哈馨

李英杰

保荐业务部门负责人: 谭旭

谭旭

内核负责人: 崔舟航

崔舟航

保荐业务负责人: 胡金泉

胡金泉

保荐机构总经理: 秦力

秦力

保荐机构法定代表人、董事长: 林传辉

林传辉



广发证券股份有限公司 (盖章)

2015年6月18日

附件：

广发证券股份有限公司保荐代表人专项授权书

北京证券交易所：

兹授权我公司保荐代表人哈馨和李英杰，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及其他有关法律、法规和证券监督管理规定，具体负责我公司担任保荐机构（主承销商）的北京康美特科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目（以下简称“本项目”）的各项保荐工作。同时指定曲可昕作为项目协办人，协助上述两名保荐代表人做好本项目的各项保荐工作。

保荐代表人哈馨最近 3 年的保荐执业情况：（1）目前无申报的在审企业；（2）最近 3 年内未曾担任除康美特上市项目外其他项目的签字保荐代表人；（3）熟练掌握保荐业务相关的法律、会计、财务管理、税务、审计等专业知识，最近 5 年内具备 36 个月以上保荐相关业务经历、最近 12 个月持续从事保荐相关业务，最近 12 个月内未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的重大监管措施，最近 36 个月内未受到中国证监会的行政处罚。

保荐代表人李英杰最近 3 年的保荐执业情况：（1）目前无申报的在审企业；（2）最近 3 年内未曾担任其他项目的签字保荐代表人；（3）熟练掌握保荐业务相关的法律、会计、财务管理、税务、审计等专业知识，最近 5 年内具备 36 个月以上保荐相关业务经历、最近 12 个月持续从事保荐相关业务，最近 12 个月内未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的重大监管措施，最近 36 个月内未受到中国证监会的行政处罚。

本保荐机构以及保荐代表人哈馨、李英杰承诺：对相关事项的真实、准确、完整性承担相应的责任。

本专项授权书之出具仅为指定我公司保荐（主承销）的北京康美特科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目的保荐代表人和项目协办人，不得用于任何其他目的或用途。如果我公司根据实际情况对上述保荐代表人或项目协办人做出调整，并重新出具相应的专项授权书的，则本专项授权书自新的专项授权书出具之日起自动失效。

（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司保荐代表人专项授权书》之签字盖章页）

保荐机构法定代表人签字：


林传辉

保荐代表人签字：



哈馨



李英杰



广发证券股份有限公司

2025年6月18日